

Molex紧凑微型SAS连接器提供服务器和存储驱动器制造商需要的传输速率和可靠性，用于连接串行SCSI (SAS) 存储器，以承担企业关键任务。

微型串行 SCSI (微型 SAS) 连接器

78394 微型SAS插头，卧式，跨装

78528 微型SAS插头，卧式，跨装，配有驱动器支座

78395 微型SAS插座，卧式，表面贴焊

78396 微型SAS插座，立式，表面贴焊

78495 微型SAS插座，卧式，双层

由于1.8英寸硬盘驱动器 (HDD) 和固态硬盘 (SSD) 的问世，我们需要有小型化的连接器产品来与之配套，以提升性能空间，满足今后若干年企业对关键的存储器连接产品的需求。微型串行SCSI (微型SAS) 连接器因此应运而生。Molex微型SAS连接器是存储器行业中用于连接1.8英寸硬盘的最小的下一代高速串行输入输出连接器，传输速率可高达6 Gbps，同时完全兼容Molex以前的微型串行ATA (微型SATA) 系列产品。这些功能允许您在同一系统中采用两种存储技术，因此可以对微型SATA进行扩展。由于微型SAS架构采用了行之有效的SCSI指令集、高级指令队列和高级验证/纠错技术，因此成为高速、高带宽SAS应用场合的理想解决方案。

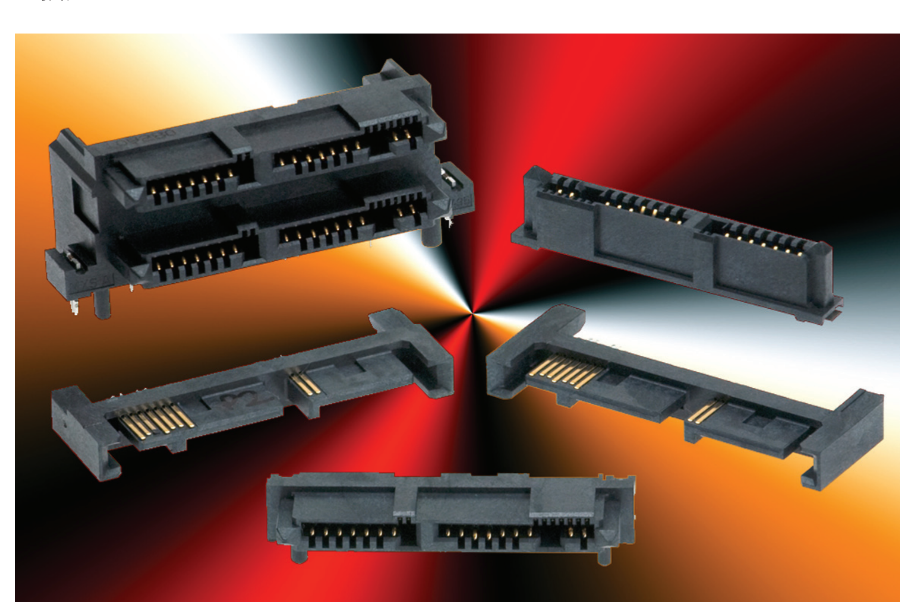
Molex微型SAS连接器符合SFF-8486规范。
SFF-8486规范定义了对微型SAS连接器物理接口和一般性能的要求，以便使其能够连接固态磁盘 (SSD) 驱动器等高速串行设备。

Molex公司提供了一系列卧式跨装插头 (从电路板边缘跨在电路板两面)，以实现超薄安装高度，满足客户要求。Molex公司还同时提供卧式和立式表面贴焊式插座，以补充其设备插头系列产品的品种。Molex最新开发了经通孔安装的双层式插座。该插座可为用户提供双倍的存储容量，而其占用面积相同于单层卧式插座的占用面积。

欲知更多产品信息，请访问我们的网站：
www.molex.com/product/microsas.html

特点和优点

- 微型SAS连接器占用面积小，可节省更多印刷电路板空间。
- 满足SAS 2.0规范要求，传输速率可高达6Gbps
- 完全兼容Molex微型SATA连接器，并可以插接外壳上带有中间肋的SATA部件
- 微型SAS插头用于1.8 英寸小型硬盘驱动器 (固态硬盘或常规硬盘)
  - 主机背板上的插座可对接Molex微型SAS或微型SATA驱动器
  - 驱动器在制造时就可以配备Molex任意一种微型SAS或微型SATA插头，并可进行SAS或SATA固件编程
- 插头上的抗压肋和插座上的双形固定栓分别为跨装插头和立式插座增加抓板力
- 78528系列插头塑壳在焊尾区设有驱动器支座外壳，是塑壳的特色功能
- 连接器上的极性键和导轨可防止部件插接不当，并确保插头顺利插入插座



Molex微型 SAS插头和插座系列产品

应用场合

- 存储驱动器
  – 固态硬盘（SSD）
  – 1.8英寸硬盘
- 服务器的存储器
  – 冗余式磁盘阵列（RAID）
  – 磁盘组（JBOD）
- 适配器
  – 主机总线适配器（HBA）

微型串行 SCSI (微型 SAS) 连接器

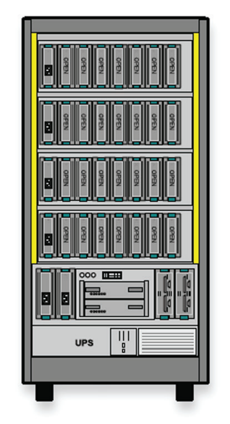
78394 微型SAS插头，卧式，跨装

78528 微型SAS插头，卧式，跨装，配有驱动器支座

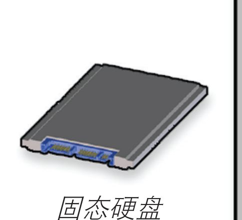
78395 微型SAS插座，卧式，表面贴焊

78396 微型SAS插座，立式，表面贴焊

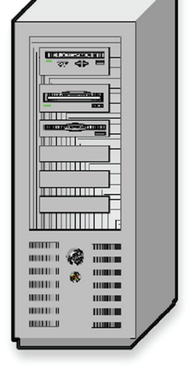
78495 微型SAS插座，卧式，双层



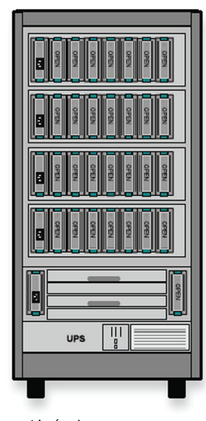
RAID存储



固态硬盘

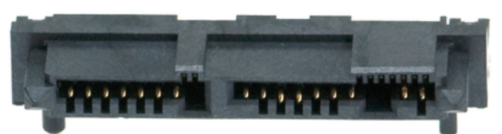


服务器硬盘

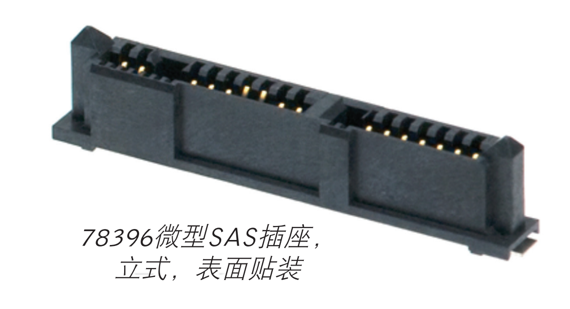


磁盘组（JBOD）存储器

系列产品



78395微型SAS插座，卧式，表面贴装



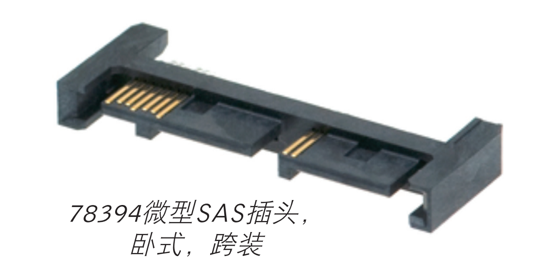
78396微型SAS插座，立式，表面贴装



78495微型SAS插座，卧式，双层



78528微型SAS插头，卧式，跨装，配有驱动器支座



78394微型SAS插头，卧式，跨装



微型串行 SCSI (微型 SAS) 连接器

78394 微型SAS插头，卧式，跨装

78528 微型SAS插头，卧式，跨装，配有驱动器支座

参考信息
包装：托盘
UL档案编号：E29179
CSA档案编号：1699020（LR19980）
对插端：78395、78396、78495 插座
设计计量单位：毫米
是否符合RoHS标准：是
是否无卤：是
是否符合灼热丝标准：否

电气参数
电压（最大值）：30伏
电流（最大值）：1.5安培直流或在60赫兹下交流（有效值）
低接触电阻（最小值）：45毫欧（初次插接）
介质耐电压：500伏交流
绝缘电阻（最小值）：1000兆欧

机械参数
连接器插入力（最大值）：20牛顿（插接背板插座）
连接器拔脱力（最小值）：2.5牛顿（插接背板插座）
端子保持力（最小值）：4.45牛顿
插拔次数（最小值）：500次（背板/盲插）

物理参数
塑壳：玻纤填充型液晶聚合物(LCP)，符合美国UL 94- 0阻燃级别，黑色
端子材料：铜合金
电镀：
接触区：0.76微米，镀金
焊尾区：2.54微米，镀锡 (78394)
- 1.91微米， 镀锡 (78528)
底层电镀：1.27微米，镀镍
印刷电路板厚度：1.00毫米
工作温度：0至+55摄氏度+55°C

订购信息

订购号	区别特征	产品属性
78394-0002	• 不带有特别的塑壳功能 • 塑壳两面齐平	25路，卧式，表面贴装，跨装插头，无卤素，无铅
78528-0001	• 在连接器焊尾区带有驱动器外壳支座，作为塑壳的特性 • 塑壳平面在一边呈梯形，另一边齐平	

规格（插座）

参考信息
包装：托盘（78395、78495）
成卷的元器件承载带（78396）
UL档案编号
：E29179（78395、78396）
：待定（78495）
CSA档案编号
：1699020（LR19980）
（78395，78396）
：待定（78495）
对插端：78394、78528插头
设计计量单位：毫米
是否符合RoHS标准：是
是否无卤：是
是否符合灼热丝标准：否

电气参数
电压（最大值）：30伏
电流（最大值）：1.5安培直流
或在60赫兹下的交流（有效值）
低接触电阻（最小值）
：45毫欧（初次插接）
（78395、78396）
：60毫欧（初次插接）（78495）
介质耐电压：
500伏交流
绝缘电阻（最小值）：
1000千兆欧

机械参数
连接器插入力（最大值）：
20牛顿（插接器件插头）
连接器拔脱力（最小值）：
2.5牛顿（插接设备插头）
端口1的部件
保持力（最小值）：3.50牛顿
端口2部件
保持力（最小值）：2.20牛顿
插拔次数（最小值）：
500次（背板/盲插）

物理参数
塑壳：玻纤填充型液晶聚合物
（LCP），符合美国UL 94-0阻燃
级别，黑色
端子和固定片/锁：铜合金
电镀：
接触区：0.76微米，镀金
焊尾区：2.54微米，镀锡
底层电镀：1.27微米，镀镍
印刷电路板厚度（最大值）
：1.00毫米（78395-0001、78396）
：1.60毫米（78395-0002）
：1.57毫米（78495-0001）
工作温度：0至+55摄氏度

微型串行 SCSI
（微型 SAS）连接器

78395 微型SAS插座，
卧式，表面贴焊

78396 微型SAS插座，
立式，表面贴焊

78495 微型SAS插座，
卧式，双层

订购信息

订购号	电路数量	印刷电路板厚度	产品属性
78395-0001	25	1.00mm	卧式，表面贴装，无卤素，无铅
78395-0002		1.60mm	
78396-0001		1.00mm	立式，表面贴装，无卤素，无铅
78495-0001	50	1.57mm	双层，通孔 卧式，无卤素，无铅



www.molex.com/product/microsas.html